

MEMSセンシング&ネットワークシステム展 2017

DNP 大日本印刷ブースのご案内

期日
2017年10月4日(水)～6日(金) 10:00～17:00

会場
幕張メッセ 国際展示場ホール7 小間番号：22-F11,F12

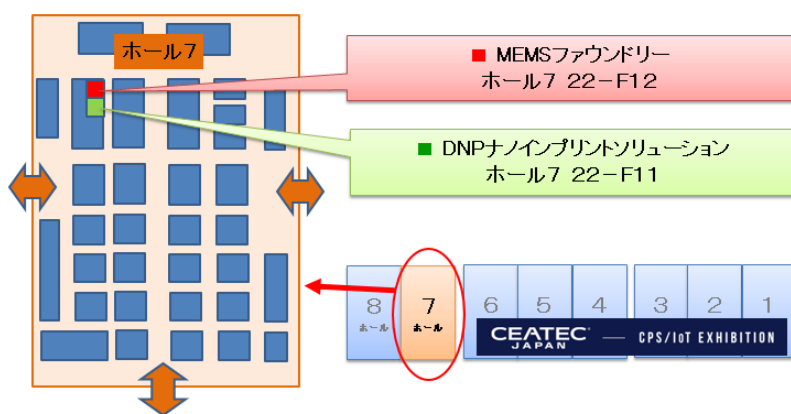
お問い合わせ
Webフォームへ

出展コンセプト

大日本印刷のMEMSファウンドリーでは、IoT時代のキーデバイスとなる、お客様のMEMS製品を確かな技術と豊富な実績で具現化いたします。

また、DNPナノインプリントソリューションでは、ナノインプリント（賦型）技術と、それを支える形状設計、金型加工、材料技術、評価技術をベースに、設計から試作検証～生産までを、お客様のニーズに合わせてトータルでサポートするサービスをご紹介します。

DNPブースのご案内



展示のご案内

MEMSファウンドリー

- 自社製品を持たず、中立的立場で量産までトータルにサポート
- MEMS製品、シリコンインターポザー、ガラスインターポザー
- 単工程、部分工程、少量でのご依頼もご相談下さい。
- 詳細は下記をご覧ください。

http://www.dnp.co.jp/works/detail/10109771_18925.html

DNPナノインプリントソリューション

回折光学素子 (DOE)

光学設計・マスターモールド製造・ナノインプリント加工をトータルでサポートする「DNPナノインプリントソリューション」の製品のひとつとして、センサーに用いられる光を整形可能な回折光学素子 (DOE) を展示いたします。また、センサー光の整形や、輝度分布制御を実現する回折光学素子及び、小さく薄い光源一体化パッケージも展示いたします。

可視光～赤外線のパターン照射、エリア照射、及び輝度分布や配光方向の制御が可能であり、広範囲のセンシングをDOE1枚で実現します。

アイセーフに有利な0次光（素抜け光）軽減技術、高精度センシングに有利な高精度配光技術などを適用したDOEのデモ展示とあわせて、センサーの小型化に好適な、小さく薄い光源とDOEの一体化パッケージも展示いたします。

- 詳細は下記をご覧ください。

http://www.dnp.co.jp/works/detail/10133811_18925.html

外部リンク